

Announcement of new article formats for KJSSF

Woo-Jung Choi^{1*}, Seok-In Yun², Won-Pyo Park³, Jin-Hyeob Kwak⁴

¹Professor, Department of Rural and Biosystems Engineering, Chonnam National University, Gwangju 61186, Korea

²Associate Professor, Department of Life and Environmental Science and Institute of Life Science and Natural Resources, Wonkwang University, Iksan 54538, Korea

³Assistant Professor, Plant Resources and Environment Major, Faculty of Bioscience and Industry, College of Applied Life Science, Jeju National University, Jeju 63243, Korea

⁴Associate Professor, Department of Rural Construction Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea

*Corresponding author: Choi WJ (Email: wjchoi@jnu.ac.kr)

Received: February 7, 2024

Revised: February 8, 2024

Accepted: February 13, 2024

Edited by

Kyung-Hwa Han,
Wonkwang University, Korea

ORCID

Choi WJ
<https://orcid.org/0000-0002-2009-8207>

Yun SI
<https://orcid.org/0000-0002-0456-9216>

Park WP
<https://orcid.org/0000-0002-6547-6240>

Kwak JH
<https://orcid.org/0000-0001-7392-0287>

토양비료학회지는 2024년 2월호 (57권 1호)부터 논문 투고 규정이 변경된다. 논문 투고 규정 (양식)은 1968년 제정된 이후 7회 개정되었지만 국제 저널 양식과 비교하여 다소 부족하거나 복잡한 양식이 존재하여, 이번에 논문 작성의 수월성과 논문의 가독성을 위해 규정을 개정하였다. 논문 투고 규정을 개정하는 주된 이유는 1) 논문의 종류를 확대함으로써 연구 접근 방식과 규모 등에서 다양한 연구 결과물을 출판하고, 2) 논문 양식을 세계 추세에 맞게 구성함으로써 저자에게는 논문 작성의 편의성을 보장하고 독자에게는 가독성을 제공하며, 3) 저자 역할과 이해관계 충돌 등에 대한 정보를 제공함으로써 연구윤리를 확보하기 위해서이다.

주요 개정 사항은 1) 현행 3종류의 논문 [연구논문 (Original research article), 연구단신 (Short communication), 연구총설 (Review)]에 논설 (Editorial)과 의견 (Opinion) 추가, 2) 논문 본문의 결론 다음에 Funding, Conflict of Interest, Author Contribution, Data Availability, 그리고 Acknowledgement 추가, 3) 표, 그림 양식 변경, 4) 참고문헌양식 변경, 그리고 5) 농촌진흥청에서 발간된 토양 및 식물체 분석법, 토양 분류, 작물 별 비료사용처방 기준 인용 표준 양식 제시 등이다.

규정은 2023년 8월 21일 편집 간사 회의 결과에 따라 논문투고 규정 개정 초안과 논문 투고 양식을 마련하였으며, 동년 11월에 편집위원 의견 수렴 후 개정안 수정을 12월 22일 제 3차 회장단 및 이사회에 제출하여 승인을 받은 후 학회 홈페이지 및 논문 투고 홈페이지에 게시하였다. 개정된 논문 투고 양식은 본 Editorial의 Supplemental Material에서도 확인 가능하며, 보다 자세한 내용은 홈페이지에 게재된 논문 투고 규정에서 확인할 수 있다.



Supplemental Material

Supplemental information is available at DOI.